

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：李蕙瑩 研究員
電話：02-2737-7150
傳真：02-2737-7607
電子信箱：vvlee@nstc.gov.tw

受文者：國立中正大學

發文日期：中華民國111年10月19日
發文字號：科會科字第1110064971號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本會與美國國家科學基金會(NSF)共同徵求「臺美先進半導體晶片設計與製作合作研究計畫(ACED Fab Program)」並將於111年11月15日及23日舉辦學術研討會(線上會議)，詳如說明，請查照轉知。

說明：

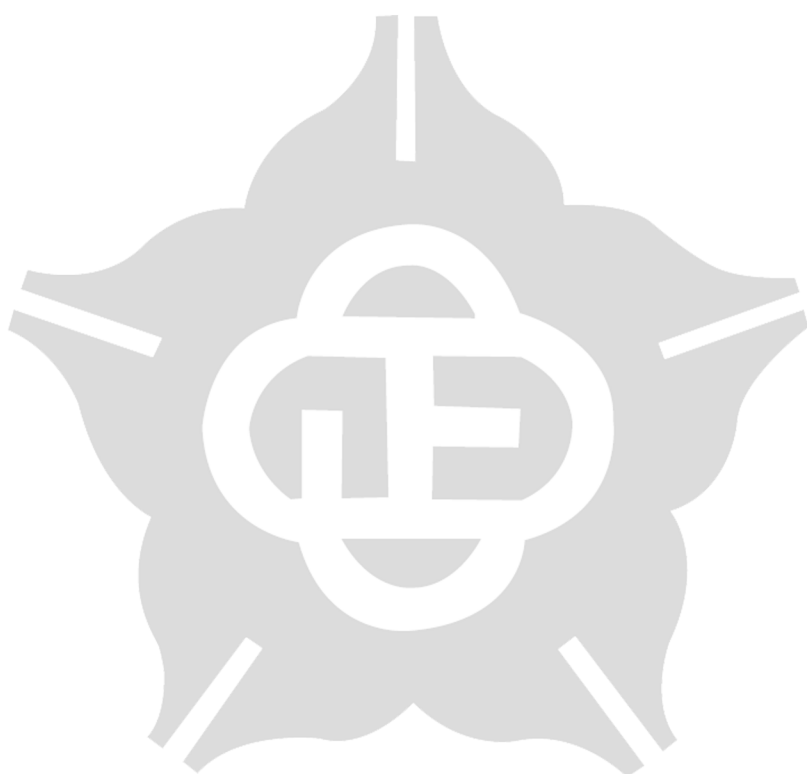
- 一、旨揭臺美雙邊合作研究計畫徵件案業以本會111年9月28日科會科字第1110060546號函知貴單位，並於本會網站「計畫徵求專區」公告。
- 二、為使更多半導體領域之學者專家參與本次共同徵件，本會與美方NSF將於11月15日及23日二日上午8時，共同舉辦「臺美先進系統晶片設計(ACED Fab)學術研討會(線上會議)」，鏈結臺美半導體領域學者互動交流，會議資訊及報名網址如下：<https://opportunityacedfab.asee.org/>，歡迎有興趣學者專家報名參加。

正本：專題研究計畫受補助單位（共301單位）

副本：本會工程處、科教國合處、駐美國代表處科技組、駐波士頓辦事處科技組、駐休士頓辦事處科技組、駐舊金山辦事處科技組、駐洛杉磯辦事處科技組

2022/10/19
16:42:22
電子公文
交換章

主任委員吳政忠



裝

訂

線

